****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec Japan K.K.** | **congatec Japan K.K.** |
| Yasuyuki Tanaka | Crysta Lee |
| Phone: +81-3-64359250 | Phone: +81-3-64359250 |
| sales-jp@congatec.com www.congatec.jp | crysta.lee@congatec.comwww.congatec.jp |



*The new SMARC 2.0 Quick Starter Kit from congatec simplifies the development of new IoT applications based on the new Apollo Lake processors*

*Text and photograph available at:* [*www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**New Product Introduction**

**SMARC 2.0 規格および最新の Intel® Atom™ 省電力プロセッサ**

**(開発コード名：Apollo Lake) の評価に必要なすべてを集約**

**Tokyo, Japan, December 9 \* \* \*** 組み込みコンピュータモジュール、シングルボードコンピュータ (SBC)、および、組み込み設計と製造サービスの大手テクノロジー企業である congatec は、11月10日に、ドイツエレクトロニカ (Germany Electronica) 展示会にて、Intel® Atom™ 省電力プロセッサ (開発コード名：Apollo Lake) 用 SMARC 2.0 スターターキットを発表します。キットは、congatec 初の SMARC 2.0 モジュール『conga-SA5』および SMARC 2.0 新規格、さらに最新世代の Intel® Atom™ 省電力プロセッサを迅速に評価したい開発者のために必要なすべてを備えています。接続型インダストリー 4.0/ワイヤレス IoT デバイスのアプリケーションエンジニアは、規格標準化されたアンテナコネクタを搭載した集積型ワイヤレスインターフェースを構築できるようになります。

「SMARC 2.0 を利用すると、高集積 IoT/インダストリー 4.0 アプリケーションの開発者は、スペース要件を最小限に抑えた、クレジットカードの大きさのオフザシェルフモジュール上に新次元のテクノロジーを搭載できるようになります。スターターキットは、さまざまな IoT 接続要件を満たすこの最新の芸術的なテクノロジーを、当社の SMARC エコシステムを使って素早く評価することを可能にする重要な機能ブロックです。クイックスターターキットには、事前に集積化され、高速 WLAN および Bluetooth LE に対応した、そのまますぐに使える SMARC 2.0 モジュールが含まれています。デュアルギガビットイーサネットインターフェースを介して、冗長化されたクラウド接続機器やセキュアなファイヤウォールソリューションにも接続できます」と、congatec の製品管理ディレクターのマーティン・ダンザー (Martin Danzer) は説明します。

**クイックスターターキットの仕様の詳細**

congatec の新しい SMARC 2.0 クイックスターターキットは、最高のパフォーマンスを誇るハイエンドコンピュータモジュール『conga-SA5』を省電力クラス用として集積しています。このモジュールには、最大 2.0 GHz のパワフルなクアッドコア Intel® Atom™ x7-E3950 プロセッサおよび 18 個の実行ユニットを装備した Intel® Gen 9 Graphics が搭載されています。また、8 GB LPDDR4 メモリを実装したこのモジュールは、最新のメモリ技術を採用しています。特筆すべきもう 1 つの点は、最大通信速度 433 Mbit/s の IEEE 802.11b/g/n/ac、Bluetooth LE、および NFC (オプション) のそれぞれの規格に対応した事前認定済み M.2 通信モジュールを備えていることです。スターターキットは、新しい SMARC 2.0 モジュールが装備するインターフェースをすべて備えています。これらは、ハードウェアベースならではの高速リアルタイム同期、MIPI CSI デュアルカメラ、USB 3.0 ポート、eMMC 5.0 準拠の 32 GB 高速フラッシュメモリおよび TPM 2.0 チップを含む、モジュール上に集積されたデュアルギガビットイーサネットインターフェースで構成されています。

conga-SEVAL 評価キャリアボードは、一般的な拡張機能をサポートする 4 つの PCIeが1 ポート、1 つのミニ PCIe ポート、2 つの USB 3.0 ポートおよび 4 つの USB 2.0 ポートを含む広範なインターフェースを備えています。また、ギガビットイーサネット対応の 2 つの RJ45 コネクタ、4 つの COM ポート、1 つの CAN バスおよび 12 個の GPIO ポートも備えています。ディスプレイは、デュアルチャネル LVDS、eDP、DP および 2 つの MIPI DSI を介して接続できます。1 つの SD/MMC ソケットおよび 1 つの SATA 6G ポートを介してストレージメディアも増設できます。さらに、I2S および HDA に対応したデジタル/アナログ音声 I/O インターフェースも備えているので、あらゆるインターフェースの機能に対応します。

クイックスターターキットは、モジュール用の ATX 電源、conga-ACA2 MIPI CSI-2 デュアルカメラモジュール、WLAN アンテナ、LVDS アダプタ、SATA、USB ケーブルおよび冷却システムを合わせて、必要な一式が完成します。ソフトウェアに関しては、congatec のスターターキットは、あらゆる Microsoft Windows 10 IoT および Linux オペレーティングシステムをサポートする conga-SA5 モジュール用ボードサポートパッケージを備えています。SMARC 2.0 アプリケーションの開発にこれ以上に簡単に着手できるキットは他にはありません。

congatec の SMARC 2.0 クイックスターターキット『conga-SKIT』 の詳細については、以下へアクセスしてください: <http://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-skit.html>

**congatec AGについて**congatec AGはドイツのデッゲンドルフに本社を置くCOM Express, Qseven, SMARC, SBCやODMサービスなどの産業用コンピュータモジュールの専業メーカです。congatecの製品は、産業用オートメーション、医療、アミューズメント、輸送、通信、計測機器やPOSなどの様々な用途に対応できます。コアな知識や技術ノウハウは、ドライバやBSPのみならずユニークなBIOS機能も含まれています。デザイン・インの段階以降も、製品のライフサイクル・マネジメントを通してサポートを提供いたします。弊社の製品は、現代の品質基準に従ったサービプロバイダのスペシャリストによって製造されています。現在、congatecは台湾、日本、米国、オーストラリア、チェコ共和国と中国に販売拠点があります。詳しくは、 www.congatec.jp へアクセスしてください。

\* \* \*

*Intel and Intel Atom are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*